

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム（SenTePack）

第2回研究会 プログラム

1、開催日時：2025 年 9 月 26 日(金) 13：00~16：35

2、開催方式：会場/Online（ハイブリッド開催）

3、開催会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11 階 第1会議室

4、会場アクセス：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>

5、プログラム：

13：00~13：10 開会挨拶 SenTePack 会長 植村 聖

13：10~13：50 WG 活動報告

- ・センシング材料 WG
- ・環境モニタリング技術 WG
- ・人・機械インタラクション WG
- ・半導体製造センシング・実装技術 WG

14：00~15：00

講演1「スマートホームのグローバル標準 Matter の最新動向と来たるスマートホーム
2.0 時代を支えるテクノロジー（仮題）」

X-HEMISTRY 株式会社 FOUNDER & CEO 新貝 文将 様

15：00~15：30 コーヒーブレイク（名刺交換・意見交換）

15：30~16：30

講演2「光電融合技術を活用する次世代コンピューティング基盤の創出（仮題）」

NTT 先端集積デバイス研究所 主任研究員 有川 勇輝 様

16：30~16：35 研究会 閉会挨拶 SenTePack 副会長 吉田 学

お問い合わせ先：

SenTePack 事務局

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシング技術研究部門

e-mail：M-SenTePack-ml@aist.go.jp